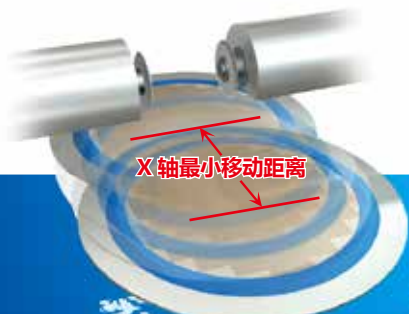


AD2000T/S

快速, 精准, 创新



X轴最小移动距离

对向型双轴机

占地面积非常小

使用本公司核心技术
占地面积大大减小
是原来机型的68%

实现快速加工

X轴 1000mm/s
Y轴 300mm/s
加工速度快、使用成本低

进化的GUI操作界面

双轴机上搭载GUI技术
标准配置HELP功能

维护性向上

大型的前部维护门
更方便进行日常的维护



东京精密自1970年开发了第一台晶圆切割机A-WD-75A以来,为高精度芯片分割和半导体产业开始时期的高效率化做出了很大的贡献。继承开发当初的技术,融合最新的Fluidics·Mechatronics·Energy Conservation技术的AD2000T,正引领新的切割技术

特征

- 1 选配单元的小型化，内部设计的优化，使得主要选配单元内藏成为可能。
- 2 标准搭载6万转的主轴
(8万转选配可对应)
- 3 加工效率向上
① X轴速度1000 mm/s, Y轴速度300 mm/s, Z轴速度80 mm/s
② 搭载2个光学式测高单元
- 4 17英寸触摸屏 + 新GUI
搭载了GUI(用户操作界面)，易于观察的画面和大型的按钮，在增强操作性的同时，采用了对话式的容易理解的输入方式
- 5 搭载了无需复杂的参数设定的刀痕检查功能
(AI刀痕检查功能)
- 6 硬盘内可存储和管理10000个以上的加工参数
- 7 标准搭载USB接口
(可以使用USB等外部存储设备)
- 8 维护性向上
大型的前部维护门改善了维护性
- 9 标准搭载节能功能
真空控制功能使压缩空气的消耗量比旧机型减少50%以上



▲ 新GUI

规格

最大工件尺寸	Φ 200 mm	
最大框架尺寸	8 inch	
主轴	最大转速	60,000 min-1
	最大刀片外径	Φ 58 mm (2英寸)
	输出功率	1.8 KW
X 轴	可切割范围	260 mm
	最高速度	1000 mm/s
Y1/Y2 轴	可切割范围	260 mm
	最高速度	300 mm/s
	分辨率	0.078 μm
	精度	0.002 mm / 210 mm
Z1/Z2 轴	行程范围	34 mm
	分辨率	0.002 μm
	最高速度	80 mm/sec
	重复精度	0.001 mm
θ 轴	旋转范围	380°
使用条件	电压	3相 AC200 to 220± 10% (可使用变压器)
	功率	6.0 kVA (MAX)
	气压	0.55 ~ 0.7 MPa
	平均气体消耗量	210 L/min (0.55 MPa)
	切割水和其他 (压力)	0.3 ~ 0.5 MPa
	切割水和其他 (最大流量)	切割水: 10.0 L/min 水帘: 3.0 L/min 其他: 0.6 L/min
	冷却水 (压力)	0.3 ~ 0.5 MPa
	冷却水 (最大流量)	3.4 L/min (0.3 MPa)
	排气量	5.0 m ³ /min 以上
	尺寸 (W*D*H)	1080 mm x 1190 mm x 1900 mm
重量	1100 kg	

注) 表中空气的消耗量以及切割水、冷却水的消耗是AD2000T的值。
本规格书有可能不经预告进行变更。



维护



大型的前部维护门改善了维护性